

2023年12月期第3四半期 決算説明会

2023年 11月8日
株式会社SUMCO
(証券コード:3436)
(LEI:353800SUSRUOM0V6KU92)

見通しに関する注意事項

本資料は一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、いかなる法域においても、当社が発行する証券の勧誘を構成するものではありません。

本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報及び将来推定は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定(当社の主観的判断に基づくものを含みます。)に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報及び将来推定と大きく異なる可能性があります。



- 総括・市場環境
- 2023年度第3四半期 決算概要(連結)
 1. 2023年度第3四半期 業績
 2. 営業利益増減分析
 3. バランス・シート、キャッシュ・フロー
- 2023年度第4四半期 業績予想(連結)
 1. 2023年度第4四半期 業績予想
 2. 営業利益増減分析
- 参考資料



総括・市場環境

代表取締役 会長兼CEO
橋本 眞幸

2023年度第3四半期 業績

(金額単位：億円)

	2023年度 3Q予想	2023年度 3Q実績	増減
売上高	1,010	1,002	▲8
営業利益	110	151	+41
経常利益	110	154	+44
親会社株主に帰属する純利益	70	93	+23
為替レート(円/US\$)	138.0	144.1	+6.1

2023年度第4四半期 業績予想

(金額単位：億円)

	2023年度 3Q実績	2023年度 4Q予想	増減
売上高	1,002	1,010	+8
営業利益	151	65	▲86
経常利益	154	50	▲104
親会社株主に帰属する純利益	93	25	▲68
為替レート(円/US\$)	144.1	145.0	+0.9

1-2. 株主還元(予想)

		第20期 (18/12)	第21期 (19/12)	第22期 (20/12)	第23期 (21/12)	第24期 (22/12)	第25期 (23/12)
配当金(円/株)	中間	30	25	18	17	36	42
	期末	32	10	9	24	45	10
	年間	62	35	27	41	81	52
配当金総額(億円)	中間	87	73	52	49	126	147
	期末	93	29	26	84	157	35
	年間	181	102	78	133	283	182
連結配当性向(%)	年間	31.0%	31.0%	30.9%	30.2%	40.4%	30.5%
自己株式取得							
金額(億円)	年間	-	33	25	-	-	-
比率(%)	年間	-	10.0%	9.8%	-	-	-
総還元性向	年間	31.0%	41.0%	40.7%	30.2%	40.4%	30.5%

(注) 補助金収入(税引後金額17億円)は配当対象から除く

■ 2023年3Q実績

- ✓ 数量 ・300mmは、ロジック・メモリーとも、顧客の生産調整が続き出荷は減少
 ・200mm以下は、全体的に市況が弱く、調整局面が続き出荷は減少
- ✓ 価格 ・300mm、200mmともに、長期契約価格は守られている

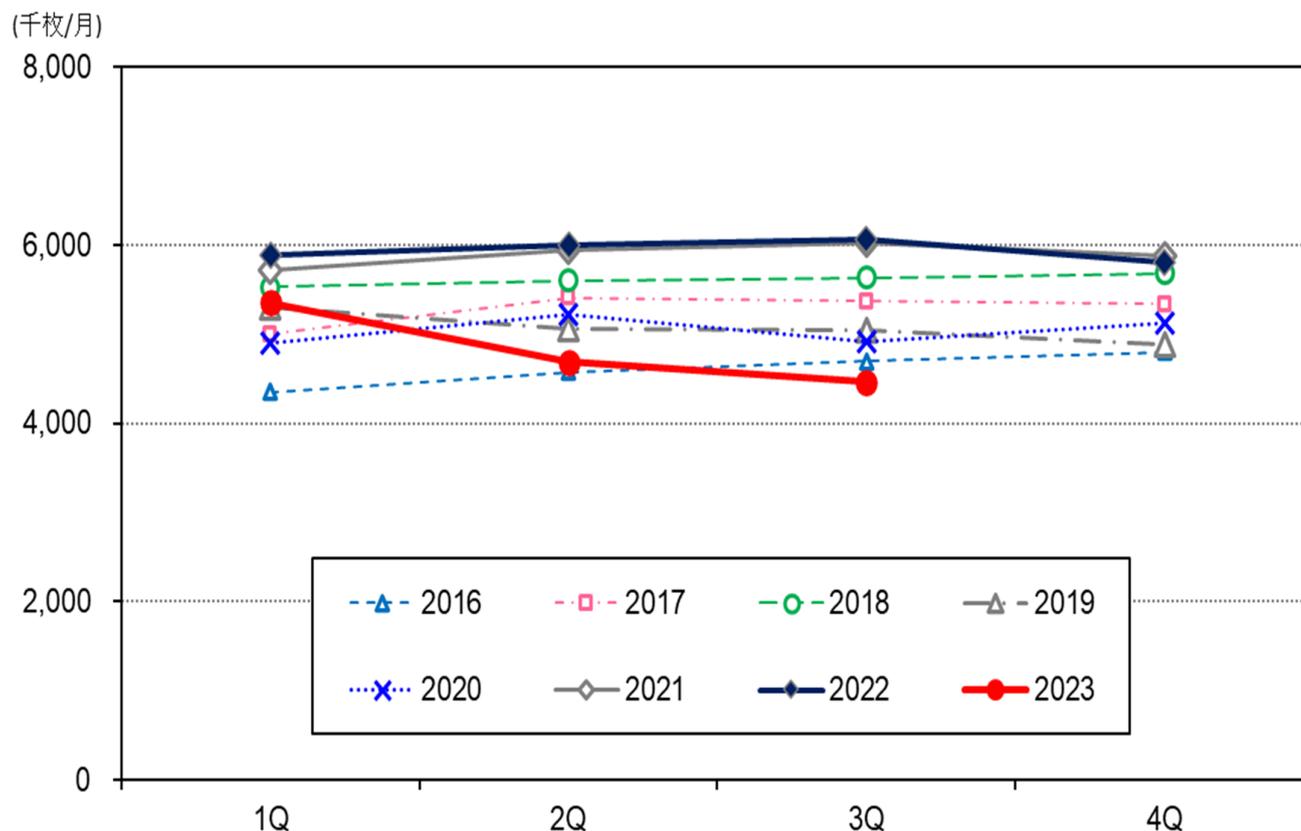
■ 2023年4Q予想

- ✓ 数量 ・300mmは、顧客の生産調整が継続する見込み
 ・200mm以下も、顧客の生産調整が継続しており出荷は減少する見込み
- ✓ 価格 ・300mm、200mmともに、長期契約価格は守られている
 小径のスポット価格は弱含み

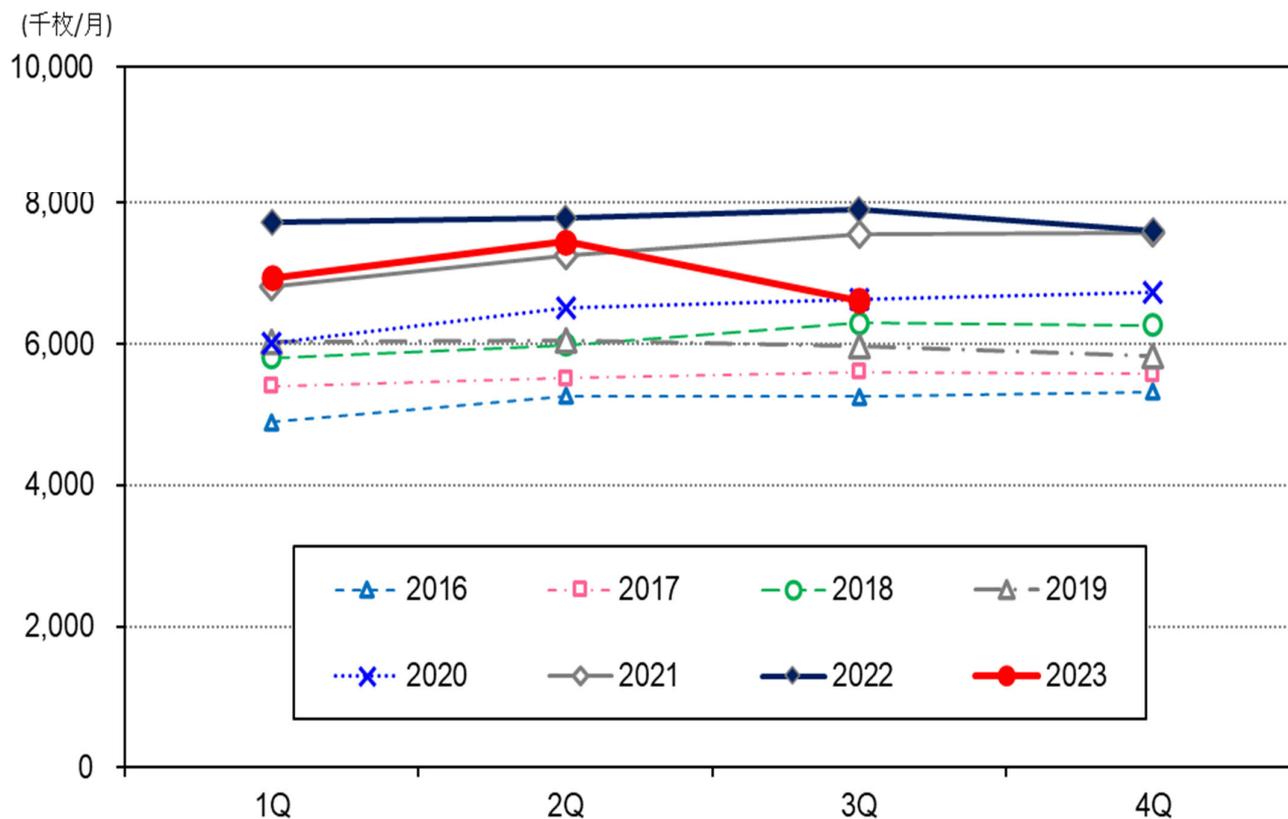
■ 今後の見通し

- ✓ 2024年はデータセンター投資や底堅いEV・エネルギー分野に加えて、低迷が続いたパソコンやスマートフォン需要の底打ちもあり、半導体生産の回復を想定
 一方で、顧客は過剰なウェーハ在庫を抱えており、発注数量が戻るまでに時間差が生じることから、シリコンウェーハ需要は2024年後半からの回復を予想

2-2. 200mmウェーハ季節変動(四半期毎)



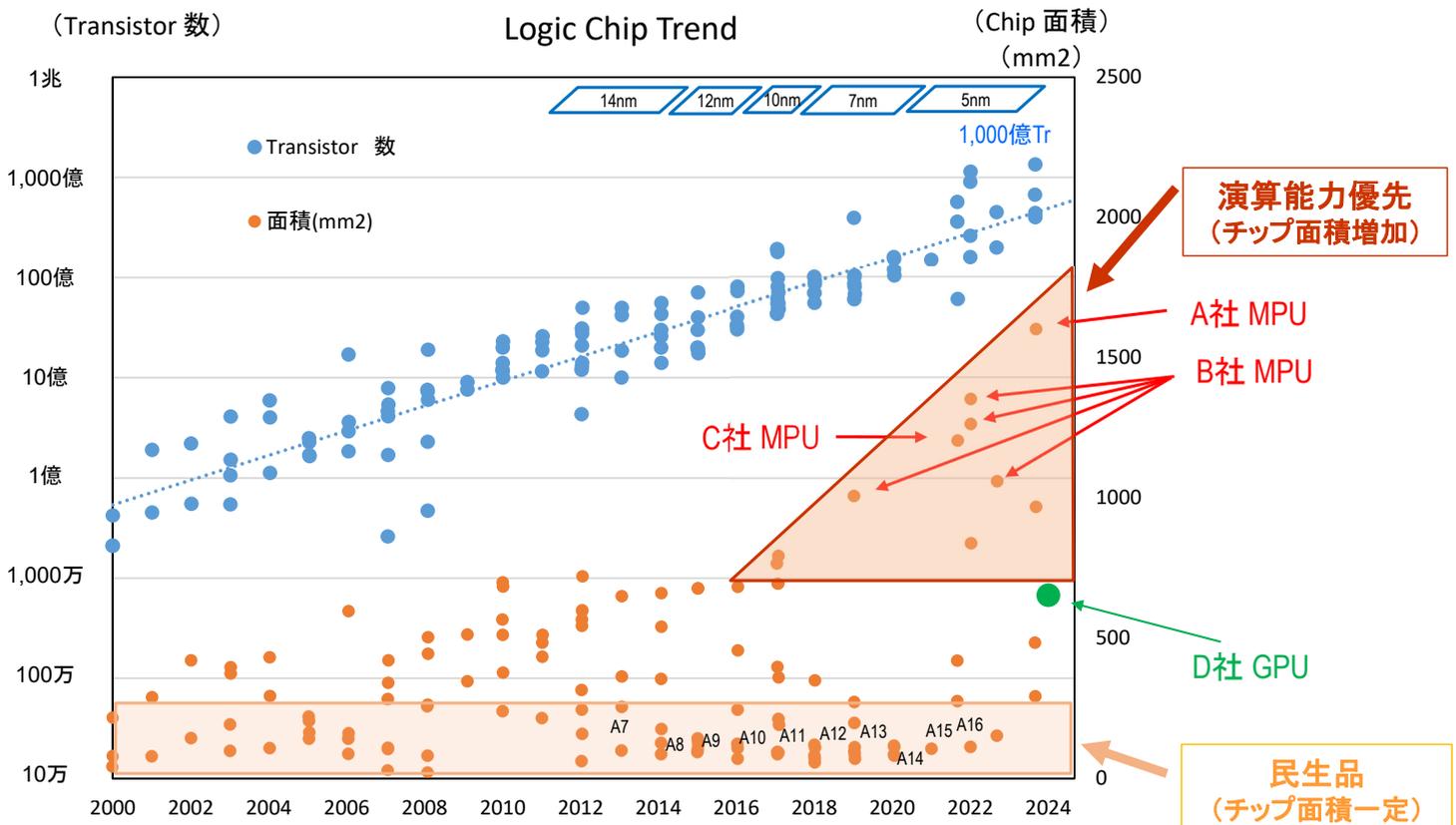
(出典: SUMCO推定)



(出典:SUMCO推定)

3. デバイス機能向上 と チップ面積の増加

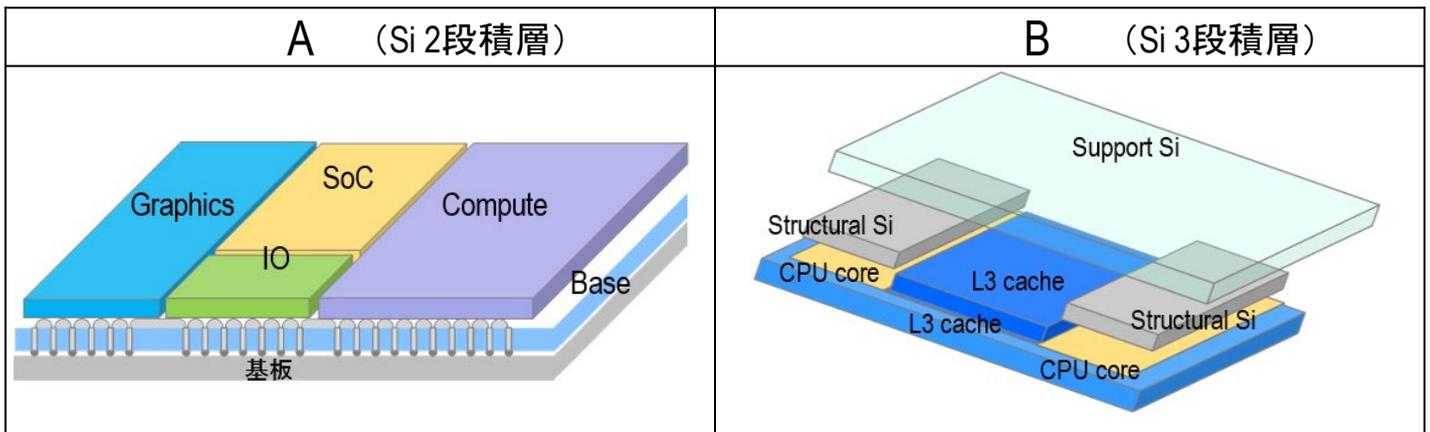
- 1-1. Logicトランジスタ数の増加とチップ面積拡大(機能向上)
- 1-2. 分割チップの組み合わせ(シリコン面積の拡大)
2. イメージセンサー チップの多層化
3. DRAMの3次元積層化(スタック)
4. 3D-NANDの性能向上
5. 最先端パッケージの構造変化(チップの複合化)



(出典: 各公表値および公開情報からSUMCO作成)

3-1-2. 分割チップの組み合わせ(シリコン面積の拡大)

多種チップの接続による高機能化例

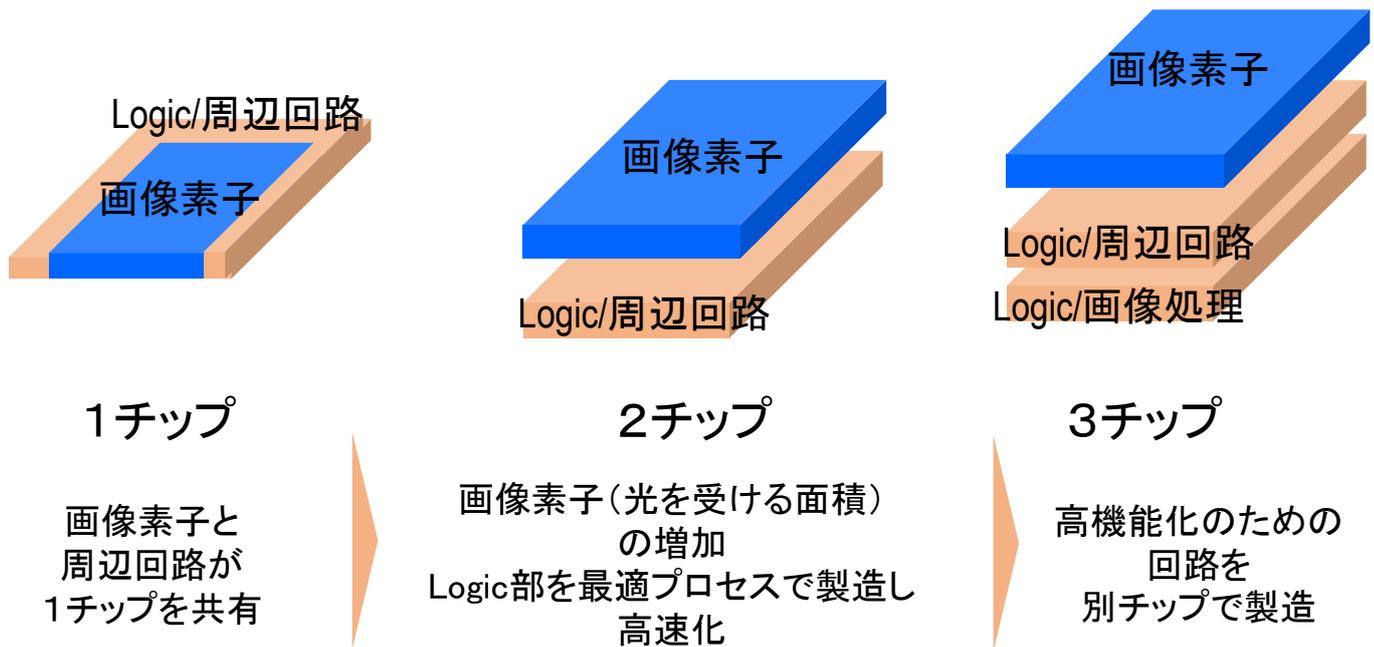


シリコンインターポージャー: 各チップ間を接続する配線などを作り込んだチップ

チップ間を接続するためのシリコンインターポージャーなどにより、シリコンウェーハ消費量が2倍以上に増加

(出典: 公開情報からSUMCO作成)

- ✓ アナログ/デジタル変換(ADC)、ロジック・配線部分を下層化
- ✓ 画像処理プロセッサ(ISP)を仮想に設置・高速処理化



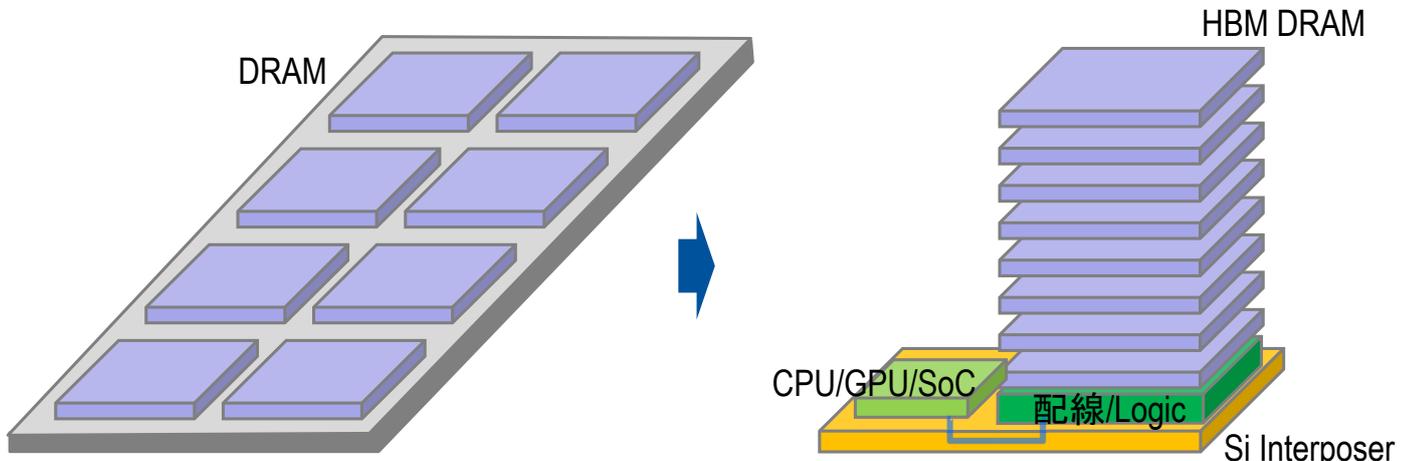
(出典: 公開情報からSUMCO作成)

3-3. DRAMの3次元積層化(スタック)

生成AI等の進展に伴い 大容量データを高速で処理
→配線等の遅延低減(HBM (High Bandwidth Memory) 化)

平面構造

積層構造 (HBM)

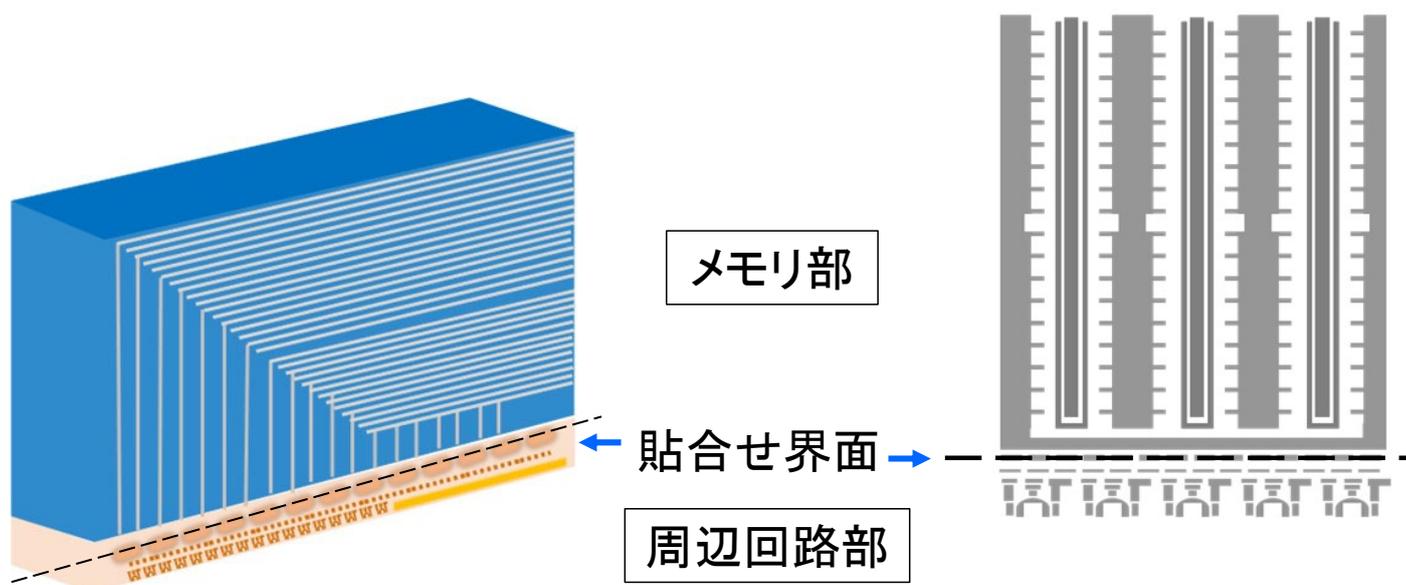


- 配線によるチップ間接続

- 配線長の大幅な削減
- TSV化による高速性(データ転送速度の高速化)
- データ転送当たりの発熱・消費電力の低減
- TSV構造による、シリコン面積拡大
- インターポーザーの採用で高速化(高密度配線)

(出典: 公開情報からSUMCO作成)

周辺回路のウェーハとメモリアレイのウェーハを貼り合わせ、ビット密度の向上と高速な転送速度を実現



シリコンウェーハ 2枚使用

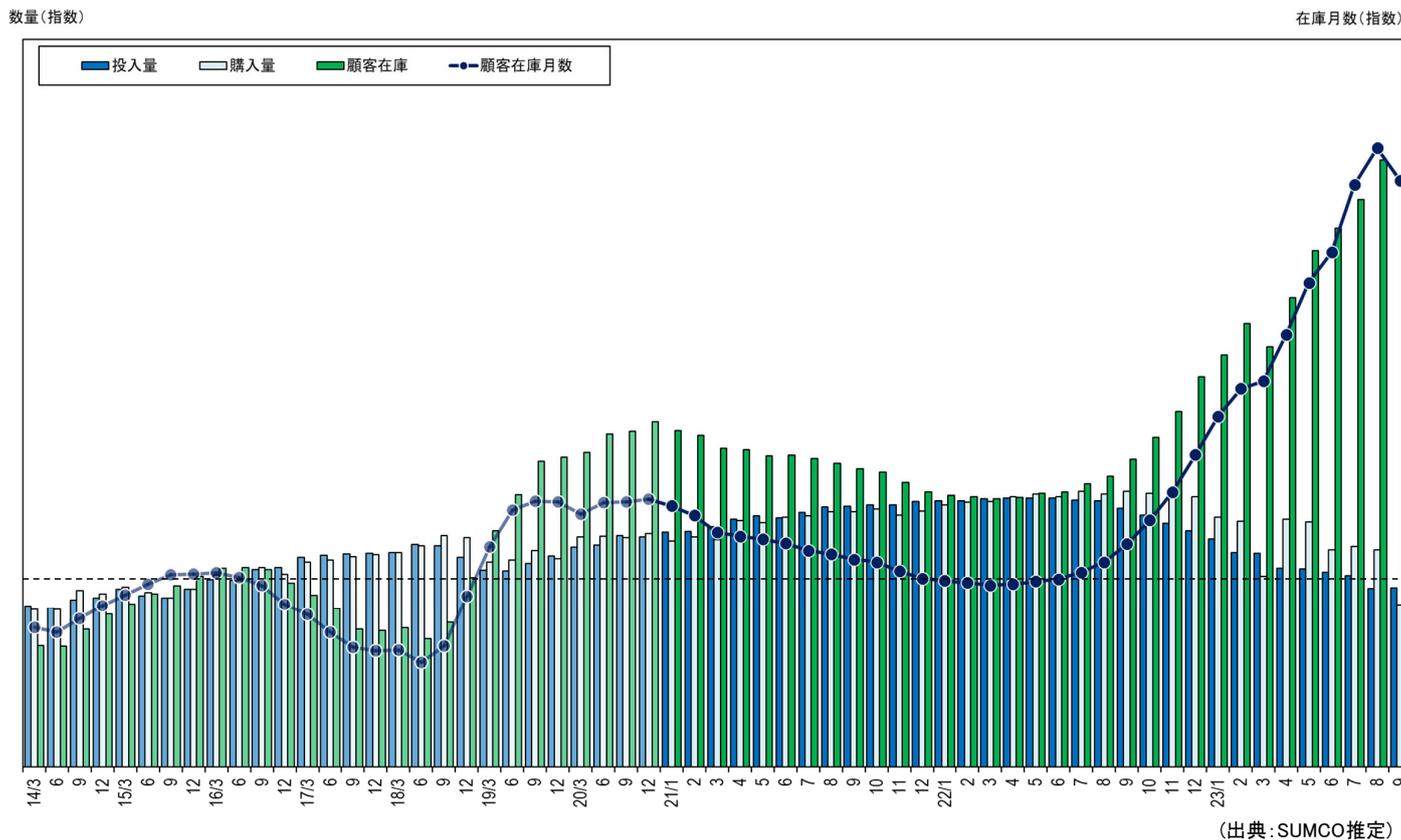
(出典: 公開情報からSUMCO作成)

3-5. 最先端パッケージの構造変化(チップの複合化)

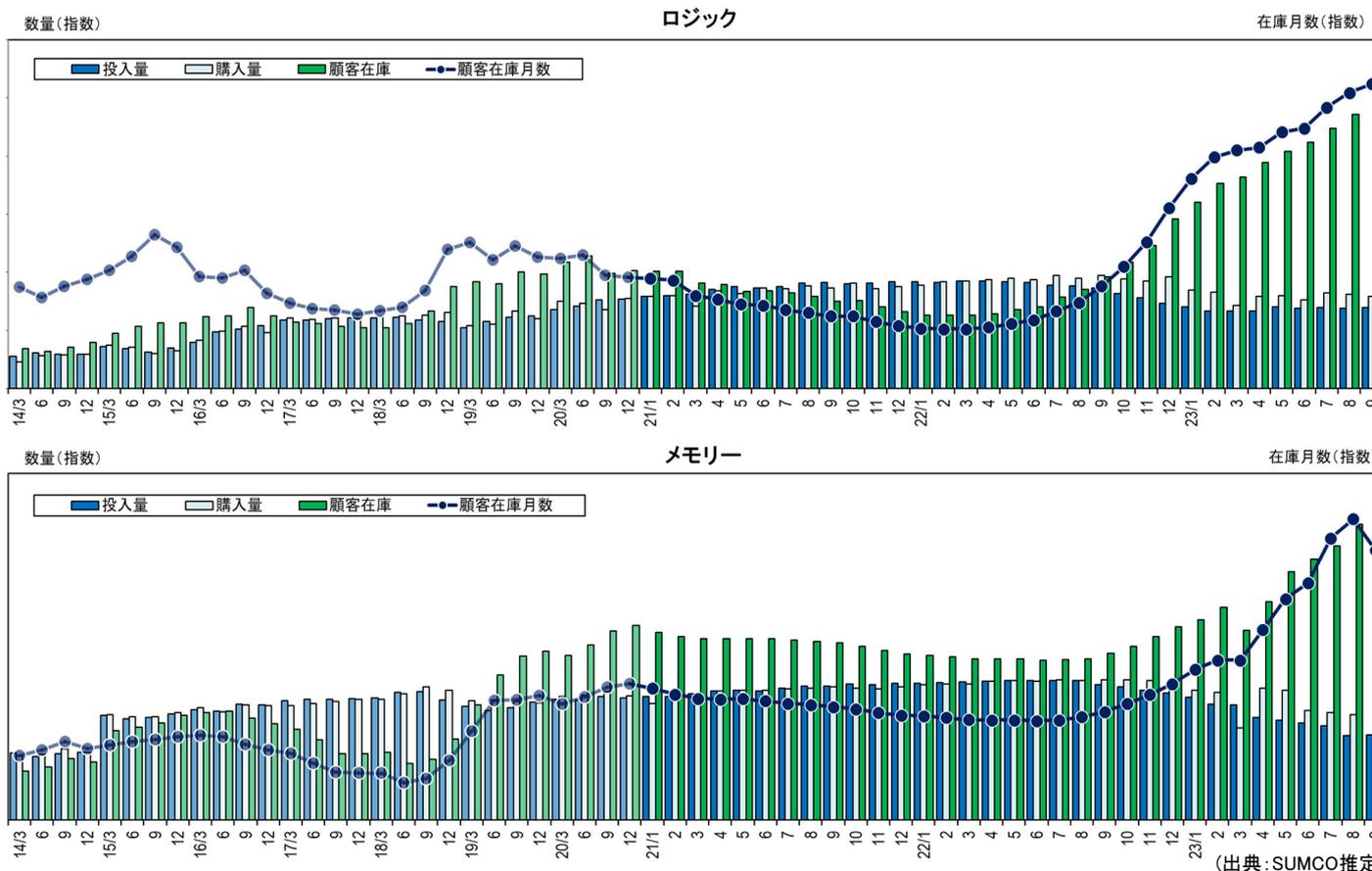
最先端の機能実現には、複数チップを組み合わせた構造が必要で、シリコンウェーハの消費面積は増大する

1. Logic 高機能化と生産性を両立させるためのチップレット化でシリコンウェーハ消費量増加
2. CIS 受光面積の増加と画像処理の高速化のため、積層化でシリコンウェーハ消費量は増加
3. DRAM 大量データを高速に処理するため、積層化でシリコンウェーハ消費量は増加
4. NAND メモリ部の高層化と周辺回路部の高速化を両立させるため、それぞれ最適なプロセスで製造し、貼り合わせるため、シリコンウェーハ消費量は増加

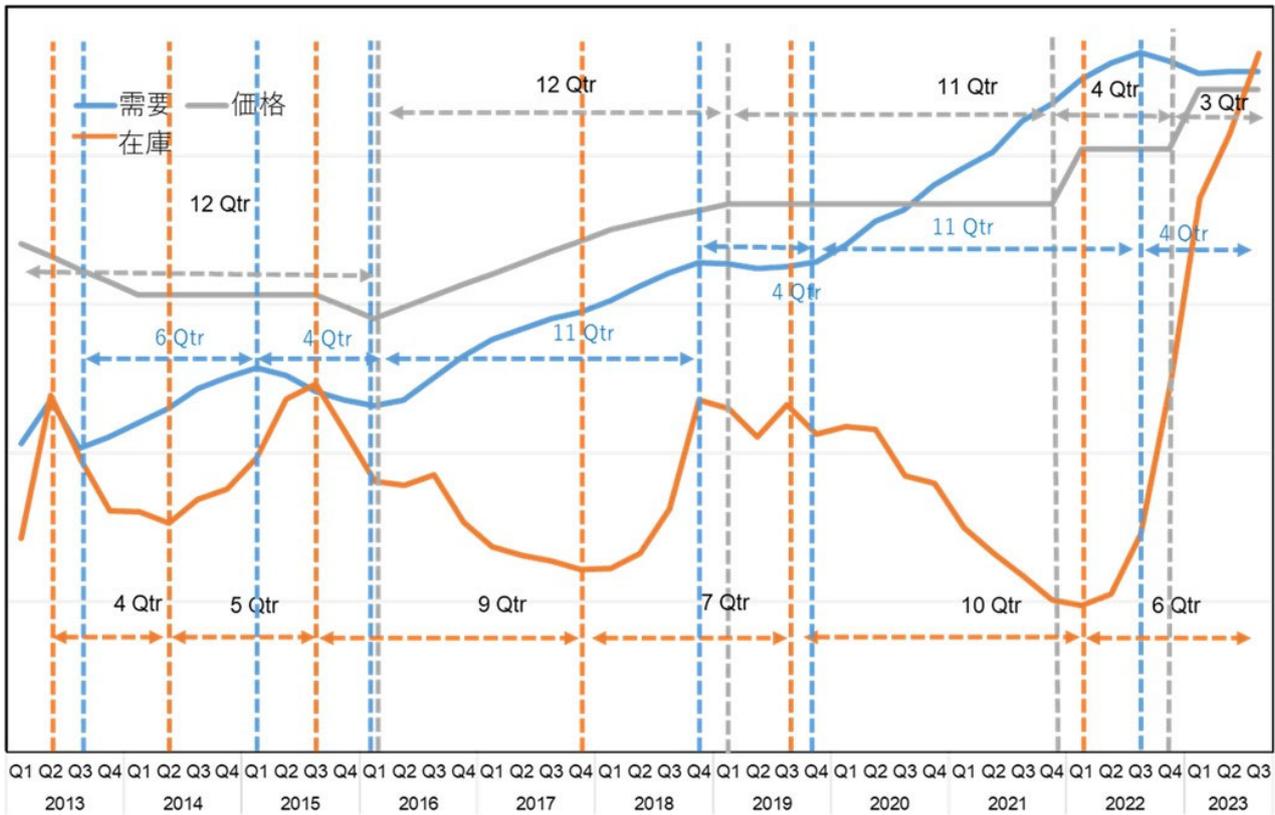
4-1. 300mmウェーハ顧客在庫推定



4-2. 300mmウェーハ顧客在庫推定(ロジック/メモリー)

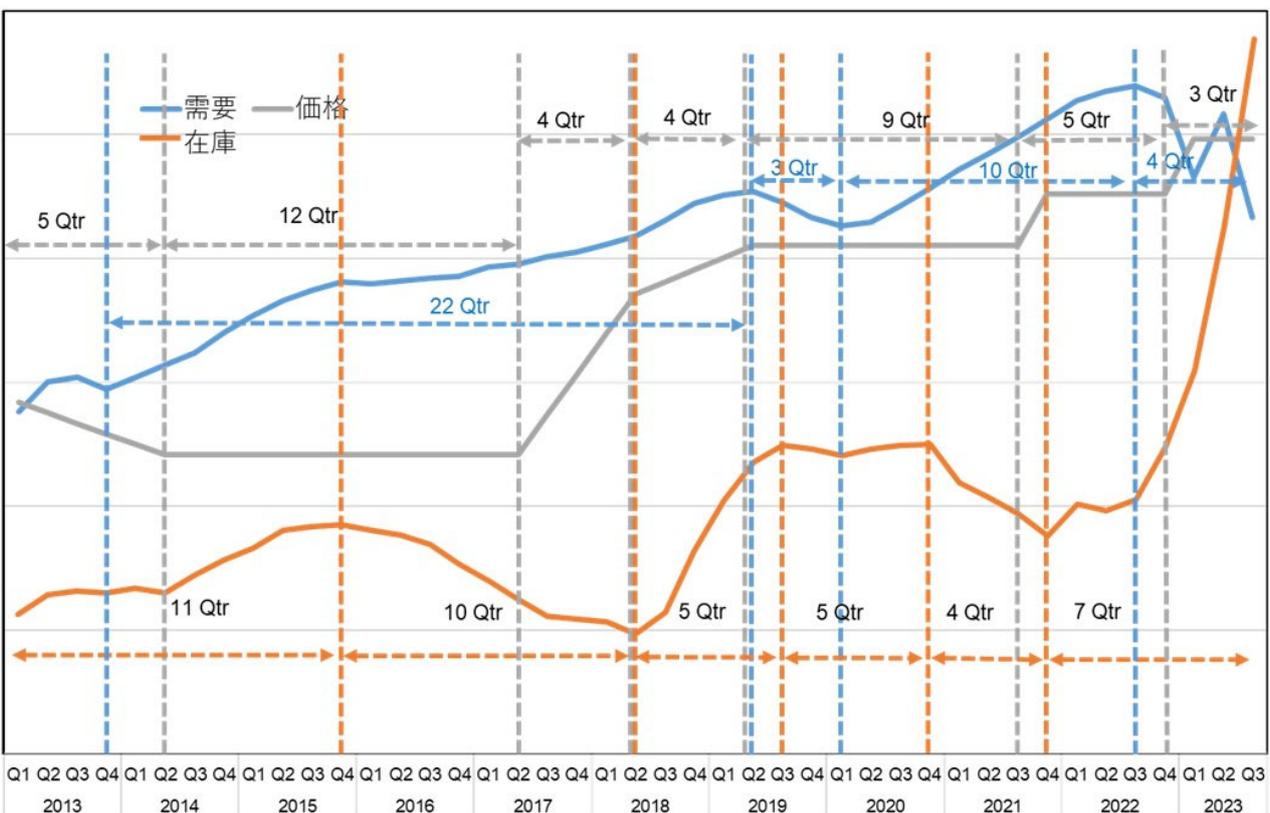


5-1. 300mm エピウェーハ需要・在庫と価格推移

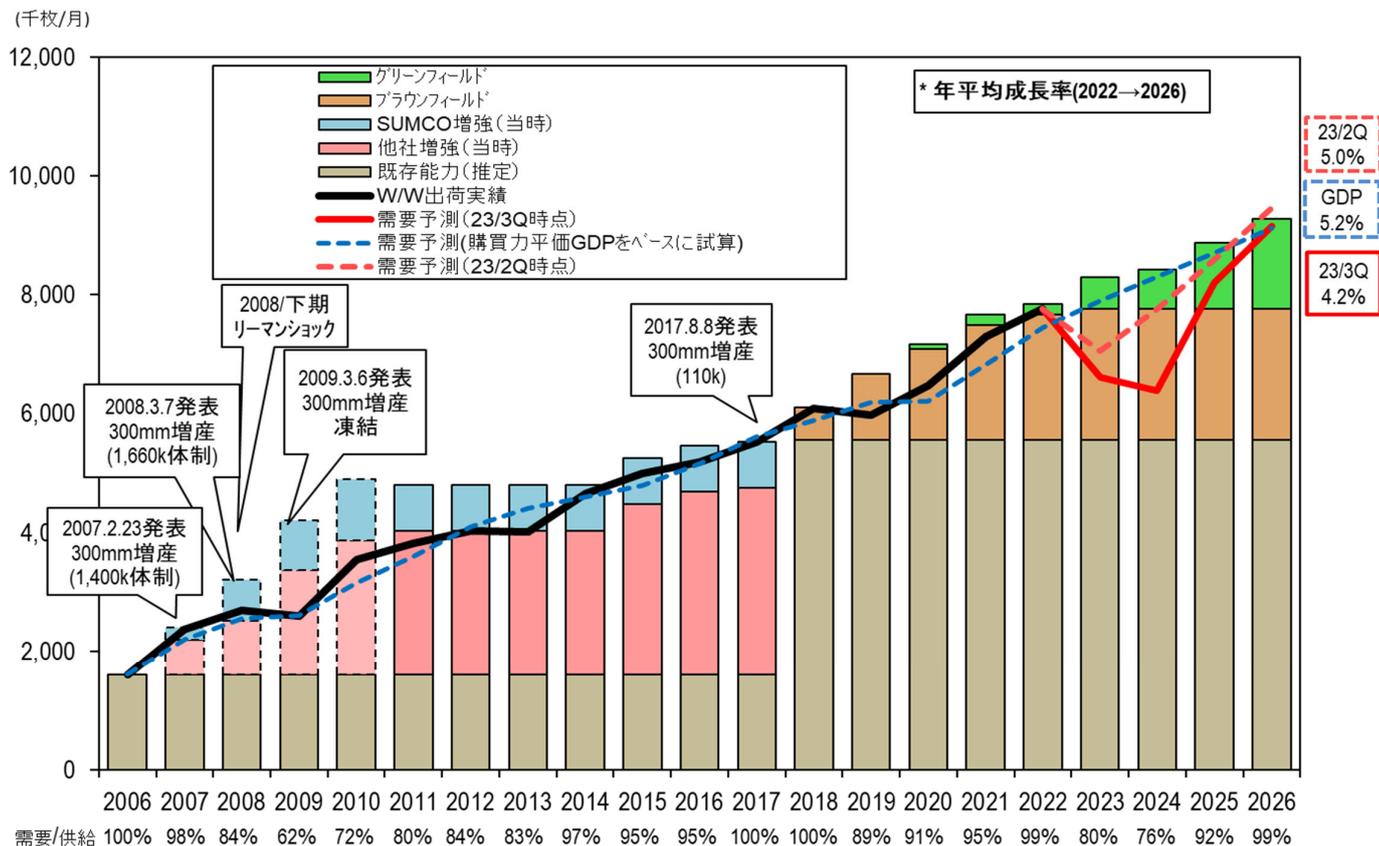


(出典: SUMCO 推定)

5-2. 300mm ポリッシュトウェーハ需要・在庫と価格推移



(出典: SUMCO 推定)



(出典: SUMCO推定)

2023年度第3四半期 決算概要(連結)

代表取締役 副会長
最高財務責任者
瀧井 道治

(金額単位：億円)

	2022年度 3Q累計	2023年度			累計	増減
		1Q	2Q	3Q		
売上高	3,236	1,099	1,107	1,002	3,208	▲28
営業利益	799	259	208	151	618	▲181
営業外損益	35	14	4	3	21	▲14
経常利益	834	273	212	154	639	▲195
特別利益	-	201	-	-	201	+201
法人税等	▲224	▲77	▲67	▲39	▲183	+41
非支配株主に帰属する純利益	▲93	▲21	▲25	▲22	▲68	+25
親会社株主に帰属する純利益	517	376	120	93	589	+72
設備投資額(検収ベース)	792	916	553	784	2,253	+1,461
減価償却費	430	140	165	192	497	+67
EBITDA (注1)	1,231	401	374	342	1,117	▲114
為替(円/US\$) (注2)	126.4	133.2	135.9	144.1	137.3	+10.9
営業利益率(%)	24.7%	23.6%	18.8%	15.0%	19.3%	▲5.4%
EBITDAマージン(%)	38.1%	36.5%	33.8%	34.2%	34.8%	▲3.3%
ROE(年率%)	13.9%	15.8%	8.5%	6.5%	12.9%	▲1.0%
1株当たり純利益(円)	147.91	107.66	34.14	26.57	168.42	+20.51

(注1) EBITDA=営業利益+営業内減価償却費+のれん償却額

(注2) 為替感応度…米ドルに対し1円の変動で年間約13億円の営業利益影響

7-2. 営業利益増減分析

1. 前四半期比

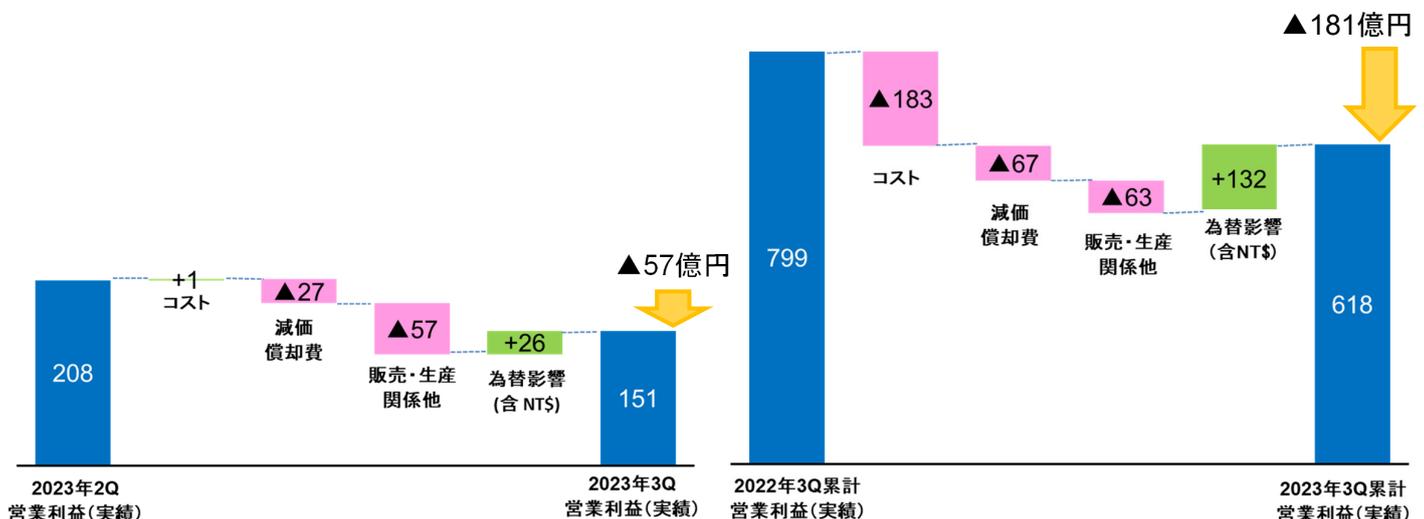
(金額単位：億円)

	2023年度 2Q実績	2023年度 3Q実績	増減
売上高	1,107	1,002	▲105
営業利益	208	151	▲57
為替(円/US\$)	135.9	144.1	+8.2

2. 前年同期比

(金額単位：億円)

	2022年度 3Q累計実績	2023年度 3Q累計実績	増減
売上高	3,236	3,208	▲28
営業利益	799	618	▲181
為替(円/US\$)	126.4	137.3	+10.9



1. バランス・シート

(金額単位: 億円)

	2022年 12月末	2023年 9月末	増減
現預金等	2,593	1,829	▲764
売上債権	899	803	▲96
製品・仕掛品	469	588	+119
原材料・貯蔵品	1,354	1,590	+236
有形・無形固定資産	3,086	4,929	+1,843
繰延税金資産	83	84	+1
その他	441	476	+35
総資産	8,925	10,299	+1,374
有利子負債	1,413	1,910	+497
その他	1,598	2,067	+469
負債	3,011	3,977	+966
資本金	1,990	1,990	-
資本剰余金	852	852	+0
利益剰余金	2,343	2,628	+285
非支配株主持分他	729	852	+123
純資産	5,914	6,322	+408
自己資本比率	59.8%	55.4%	▲4.4%
1株当たり純資産額(円)	1,523.7	1,630.5	+106.8
D/E レシオ(グロス)(倍)	0.26	0.34	+0.08
D/E レシオ(ネット)(倍)	△0.22	+0.01	+0.23

2. キャッシュ・フロー

(金額単位: 億円)

	2023年度 3Q累計
税引前純利益	840
特別利益	▲201
減価償却費	497
小計	1,136
棚卸資産増減	▲164
その他	▲223
営業キャッシュ・フロー	749
設備投資(検収ベース)	▲2,253
子会社株式取得による収入	99
設備債務増減他	465
投資キャッシュ・フロー	▲1,689
フリー・キャッシュ・フロー	▲940
資金使途	
配当金支払	▲374
資金調達	490
換算差額他	60
現預金増減	▲764

2023年度第4四半期
業績予想(連結)

(金額単位：億円)

	2022年度実績	2023年度予想				累計	増減
		1Q実績	2Q実績	3Q実績	4Q予想		
売上高	4,410	1,099	1,107	1,002	1,010	4,218	▲192
営業利益	1,096	259	208	151	65	683	▲413
営業外損益	17	14	4	3	▲15	6	▲11
経常利益	1,113	273	212	154	50	689	▲424
特別利益	-	201	-	-	-	201	+201
法人税等	▲295	▲77	▲67	▲39	▲10	▲193	+102
非支配株主に帰属する純利益	▲116	▲21	▲25	▲22	▲15	▲83	+33
親会社株主に帰属する純利益	702	376	120	93	25	614	▲88
減価償却費	595	140	165	192	221	718	+123
EBITDA	1,695	401	374	342	286	1,403	▲292
為替(円/US\$)(注)	131.0	133.2	135.9	144.1	145.0	139.5	+8.5
営業利益率(%)	24.9%	23.6%	18.8%	15.0%	6.4%	16.2%	▲8.7%
EBITDAマージン(%)	38.4%	36.5%	33.8%	34.2%	28.3%	33.3%	▲5.1%
ROE(年率%)	13.9%	15.8%	8.5%	6.5%	1.8%	11.1%	▲2.8%
1株当たり純利益(円)	200.49	107.66	34.14	26.57	7.15	175.60	▲24.89

(注) 為替感応度…米ドルに対し1円の変動で年間約13億円の営業利益影響

8-2. 営業利益増減分析

1. 前四半期比

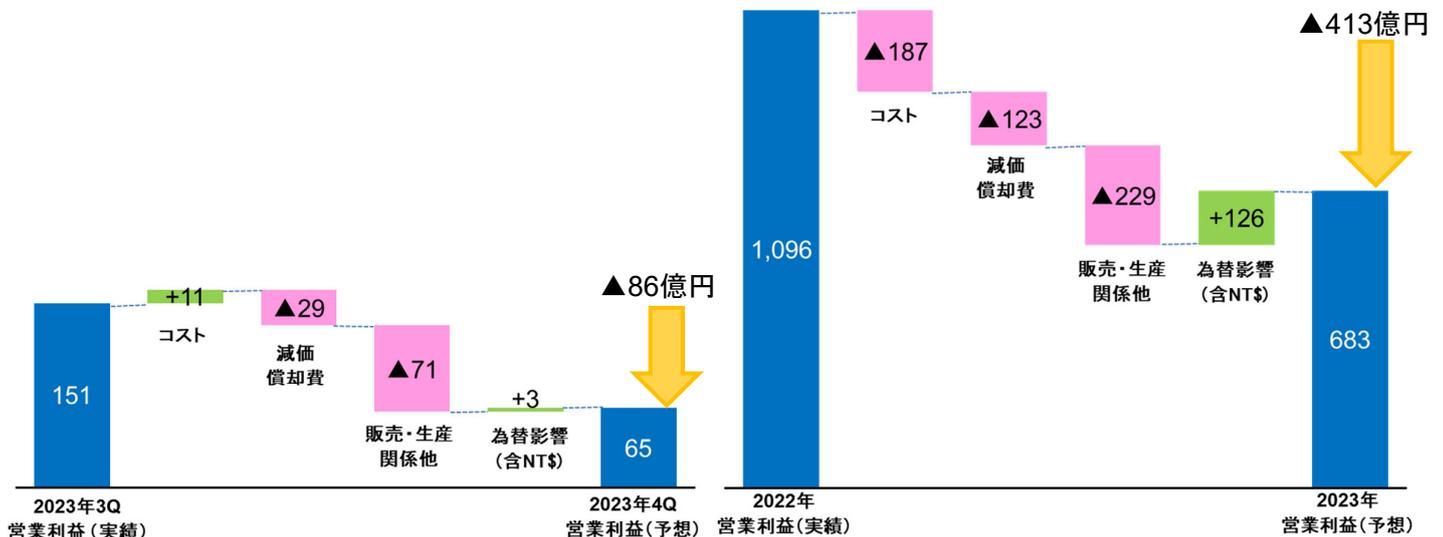
(金額単位：億円)

	2023年度3Q実績	2023年度4Q予想	増減
売上高	1,002	1,010	+8
営業利益	151	65	▲86
為替(円/US\$)	144.1	145.0	+0.9

2. 前年比

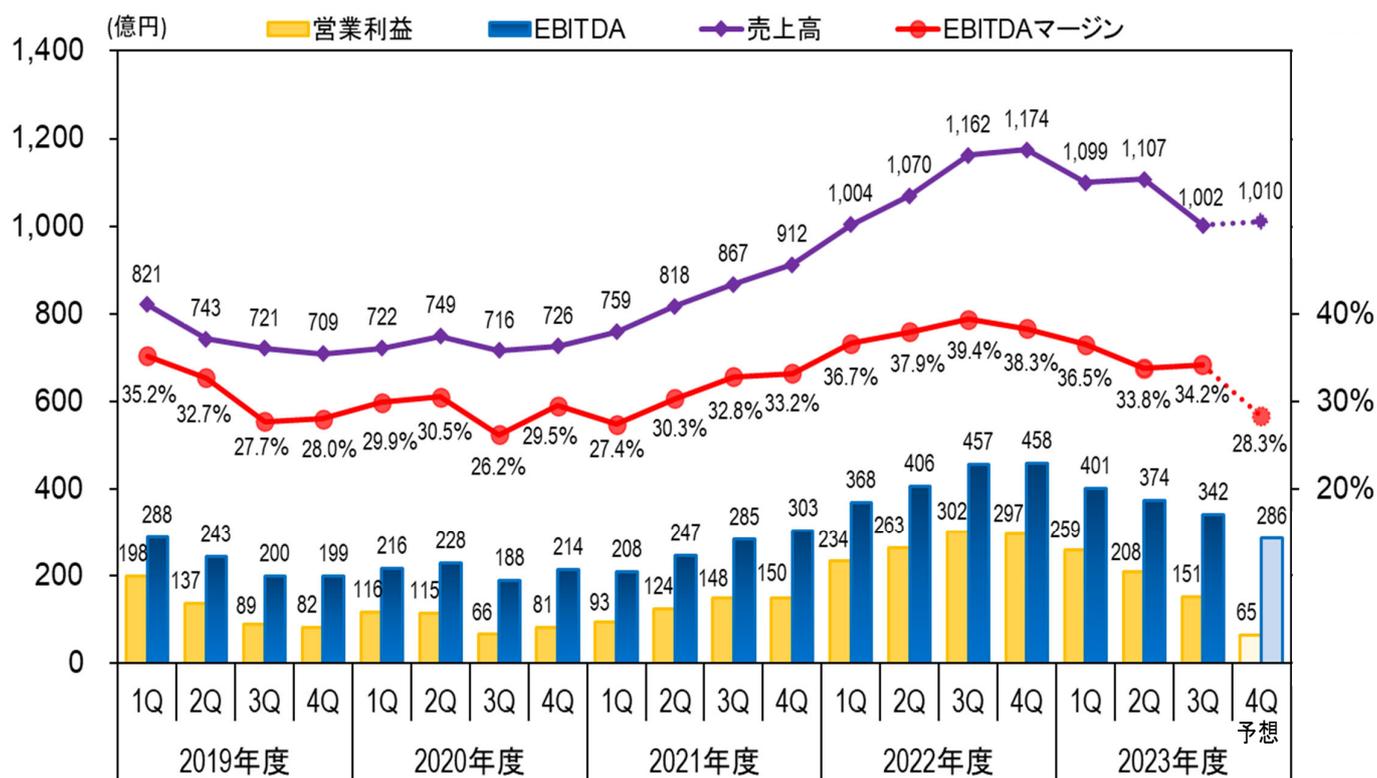
(金額単位：億円)

	2022年度実績	2023年度予想	増減
売上高	4,410	4,218	▲192
営業利益	1,096	683	▲413
為替(円/US\$)	131.0	139.5	+8.5



参考資料

■ 四半期業績推移





URL <https://www.sumcosi.com/>